



⑥	④	1,2-178294-5
⑥	③	1,2-178294-3
⑥	②	1,2-178294-2
(FINISH)		製品番号 (PART NO.)

推奨基板取付け寸法
PC 基板厚: 1.6±0.1
(非累積公差)
(コネクタ搭載面)

RECOMEND PC BOARD HOLE PATTERN
PC BOARD THICKNESS: 1.6±0.1
(NOT ACCUMULATE TOLERANCE)
注記 (CONNECTOR MOUNT SIDE)

NOTES

- MATERIAL: HOUSING: GLASS FILED THERMO PLASTIC, POLYESTER
CONTACT: COPPER ALLOY
RETENTION LEG: COPPER ALLOY
- FINISH (CONTACT AREA): 0.38μm MIN GOLD PLATING OVER Ni PLATING
- FINISH (CONTACT AREA): 0.76μm MIN GOLD PLATING OVER Ni PLATING
- FINISH (CONTACT AREA): 2.0 μm MIN TIN PLATED OVER NICKEL
- FINISH (RETENTION LEG): TIN LEAD PLATED (CONTACT TAIL) OVER NICKEL
- FINISH (RETENTION LEG): TIN PLATED (CONTACT TAIL) OVER NICKEL
- THE SHAPE, SIZE AND POSITION OF THE CHARACTER SHOW THE OUTLINE THEY DON'T SHOW DETAILS
- THE DATE CODE SHOW PRODUCTION LOT BY NUMBER. THE NUMBER MAKE UP THE NUMBER OF FOUR COLUMNS OR FIVE COLUMNS. (INCLUDE THE ALPHABET)

1. 材料: ハウジング: ガラス入り熱可塑性
ポリエステル樹脂
コネクタ: 銅合金
リテンションレグ: 銅合金

② めっき: コネクタ: 全面Ni下地
接触部: 0.38μm MIN金めっき

③ めっき: コネクタ: 全面Ni下地
接触部: 0.76μm MIN金めっき

④ めっき: コネクタ: 全面Ni下地
接触部: 2.0 μm MINスズめっき

⑤ めっき: リテンションレグとコネクタ半田付部
ニッケル下地の土に半田めっき

⑥ めっき: リテンションレグとコネクタ半田付部
ニッケル下地の土にスズめっき

7. 文字の形状、大きさ、および位置については、大略を示すものであり、詳細を示すものではありません

⑧ 4桁の数字及びアルファベットを含む5桁の数字により製造ロットを示す。

B1	REVISED (ECR-08-029637)	T.S	A.O	21 NOV 2008
B	REVISED (FJDO-0039-03)	T.S	SM	2 JUN '03
A	REVISED (FJDO-0114-03)	T.S	SM	25 APR '03
0	RELEASED (FJ00-1468-94)	K.I	SM	1-10 '95
LTR	REVISION RECORD	DR	CHK	DATE

Copyright © 1994
AMP(Japan) LTD.
ALL RIGHTS RESERVED.

Tyco Electronics Tyco Electronics Corporation
Kawasaki, Japan

ダイナミック 3100 シリーズ
4極 ヘッダーアセンブリー (水平タイプ)
4 POS SINGLE ROW
HORIZONTAL HDR ASS'Y FOR DYNAMIC 3100

一般公差 (GENERAL TOLERANCE)

SIZE	LOC	NUMBER
A3	J	C-178294

SCALE 2-1 REV. B1 SHEET 1 OF 1

DR. 22/DEC/94 DE. 22/DEC/94
K.IKEDA K.IKEDA

CHK. 10/JAN/95 APP. 10/JAN/95
S. MANABE S. MANABE